



Automatic Surface Grinder DAG810

適合最新加工需要的自動研削

結構精煉的單軸自動研削機

最大可加工 $\phi 8$ 英寸工作物的單軸，單工作台小型自動研削機。

佔地面積僅為1.02m²的簡潔設計

設備尺寸為600 (W) × 1,700 (D) × 1,780 (H) mm。

佔地面積只有1.02 m²。

可保證高精度研削的機械結構及研削方式

通過採用最新開發的高剛性，低振動主軸，保證了高精度的研削加工品質。研削方式有縱向切入式研削和橫向蠕動式研削（作為特殊選配）。

適用於研削各種材料

除了硅（矽）晶圓外，還可加工各種硬脆材料和電子元件。



操作簡便

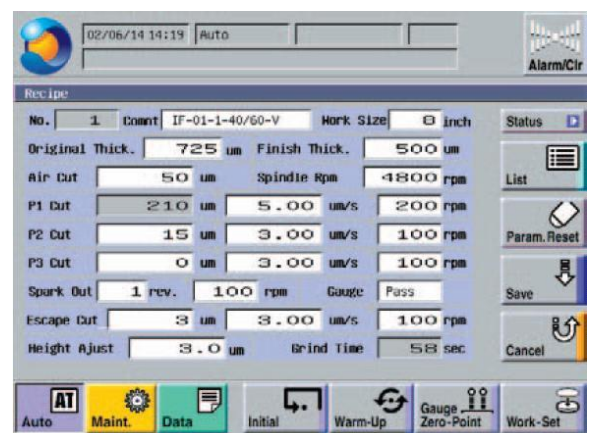
DAG810配置了觸摸式液晶顯示器及圖形化用戶介面GUI（Graphical User Interface），提高了操作便利性。而且設備的機械狀態和加工狀況可在控制畫面上同步顯示，操作人員只要觸摸控制畫面上的按鈕，就可以簡單地完成操作。

可滿足各種加工要求（選配）

- 可裝配單探針式高度計或雙探針式高度計（特殊選項）
- 縱向切入式研削，最大加工直徑可擴大到 $\phi 300$ mm（特殊選項）
- 加工帶切割框架的晶圓時，加工直徑可達 $\phi 8$ 英寸（特殊選項）
- 橫向蠕動式研磨，最大加工直徑可擴大到 $\phi 200$ mm（特殊規格）

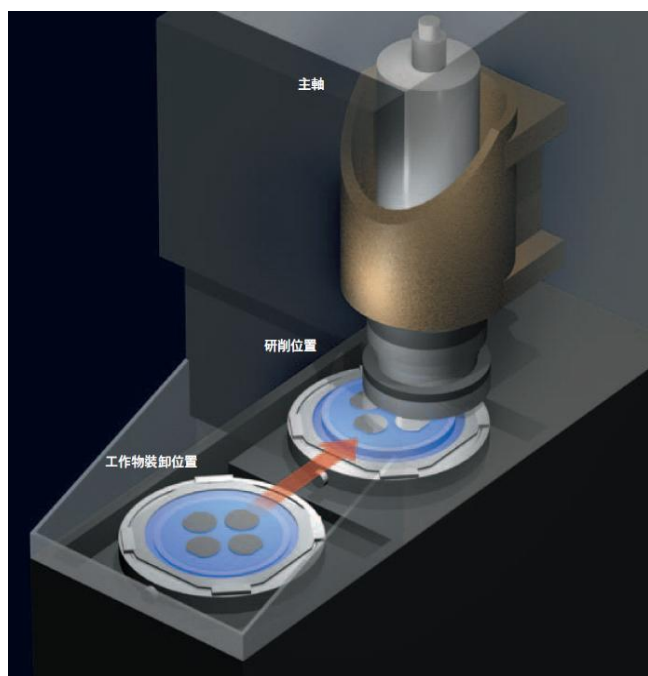
高精度加工應用實例

- 可用於硅（矽）晶圓，半導體化合物等的研削分析
- 可用於CSP / WL-CSP的樹脂研削及銅電極露出加工
- 用於提高LT / LN等的平面度
- 還可加工未燒結陶瓷、藍寶石（小直徑）等



操作畫面

Automatic Surface Grinder DAG810



*帶框架的研磨需要使用專用的夾具（選配）

Specifications			
Specification	Unit		
Wafer Diameter	mm	φ 200 (φ 4"/5"/6"/8" with universal chuck table use)	
Grinding Method	-	Anomalous In-feed grinding with wafer rotation	
Grinding Wheels	mm	Φ200 Diamond Wheel	
Spindle	Output	kW	4.2
	Rated torque	N·m	5.9
	Revolution speed range	min ⁻¹	1,000 - 7,000
Machine dimensions(WxDxH)	mm	600 × 1,700 × 1,780	
Machine weight	kg	Approx.1,300	

■使用條件

- 請使用大氣壓露點在-15 °C以下，殘餘油分為0.1 ppm，過濾度在0.01 μm/99.5 %以上的清潔壓縮空氣。
- 請將放置機械設備的房間室溫設定在20 °C~25 °C之間，並將波動範圍控制在±1 °C以內。
- 請將切削水的水溫控制為室溫+0~2 °C（波動範圍在±1 °C以內），將冷卻水的水溫控制為與室溫相同（波動範圍在±1 °C以內）。
- 其他，請避免設備受到撞擊及外界的有感振動。另外，請不要將設備安裝在鼓風機、通風口、產生高溫的裝置及產生油霧的裝置附近。
- 本設備會使用水。萬一發生漏水影響，請把本設備安裝在有防水性之地板及有排水處理之場所。
- ※ 為了改進設備，本公司可能在預先不通知用戶的情況下，就對本規格實施變更，因此請仔細確認規格後發出訂單。
- ※ 壓力全部使用壓力錶指示壓力值表示。
- ※ 關於本設備的應用技術等諮詢，請與本公司銷售部門聯絡。
- ※ 如需使用純水以外的研磨液，請向本公司銷售擔當諮詢。